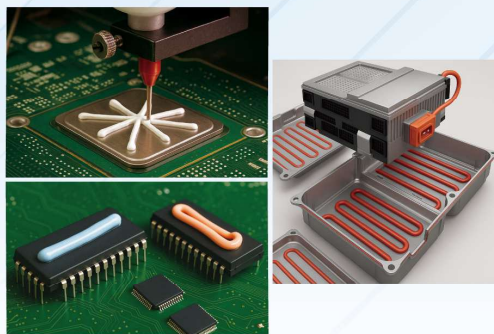


熱伝導パテ Putty

非硬化性の粘弾性状態を維持しながら、熱インターフェースのギャップフィラーとして機能します。
部品間の最適な放熱を実現するとともに、自動化プロセスへの適用にも最適化されています。

※ Color : Change as requested

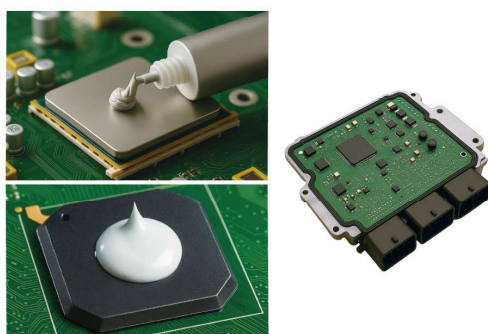


Grade	熱伝導率 (W/m-K)	フローレート (g/min) @90psi,30cc syringe	密度 (g/cm³)	粘度 ⁽¹⁾ (Pa-s)	色
SWA-PT3501	≥ 3.5	10~20	2.9~3.5	850~1,050	Blue
SWA-PT5001	≥ 5.0	10~20	2.9~3.6	850~1,050	Blue
SWA-PT7001	≥ 7.0	5~15	3.0~3.7	1,250~1,550	Gray
SWA-PT8001	≥ 8.0	5~15	3.0~3.7	1,450~1,750	Gray

(1) Brookfield HBDV-II+P (spindle.#14, 1 rpm @25°C)

グリース Grease

電子機器や半導体における熱抵抗を最小限に抑え、効率的な熱伝導を実現します。
高温環境下でも安定した性能と優れたギャップ充填性を維持します。



Grade	熱伝導率 (W/m-K)	ボンドライン 厚さ (BLT, μm)	フローレート (g/min) @90psi,30cc syringe	密度 (g/cm³)	粘度 (Pa-s)	色
SWA-GR3501	≥ 3.5	20~25	20~40	2.9~3.2	90~110	Gray
SWA-GR6001	≥ 6.0	20~25	20~40	2.3~2.9	90~110	Gray

ディファレンシャルパッドタイプ Differential pad

ディファレンシャルパッドは、両面で粘着性が異なるシリコーン製サーマルパッドです。
非粘着面からのリワークが可能です。

※ Color, Size : Change as requested



Grade	熱伝導率 (W/m-K)	硬度 (Shore 00)	引張強度 (MPa)	絶縁破壊電圧 (kV)	体積抵抗率 (Ω-cm)	厚さ (mm)
TP-M30D-SWA	≥ 3.0	60~80	> 0.1	> 5	> 10 ¹³	1.0~3.0
TP-M50D-SWA	≥ 4.5	60~80	> 0.1	> 5	> 10 ¹³	1.0~3.0